

平成 25 年 6 月 24 日

各 位

会 社 名 シャープ株式会社
代 表 者 名 取締役社長 奥田隆司
(コード番号 6753)

第三者割当による新株式発行の払込完了に関するお知らせ

当社と Qualcomm Incorporated (以下「Qualcomm」といいます。)の100%出資子会社である Pixtronix, Inc. との間の次世代の MEMS (Micro Electro Mechanical System: 微小電子機械システム) ディスプレイの共同開発を目的とする業務提携に関する平成 24 年 12 月 4 日付の共同開発契約、及び Qualcomm との間の第三者割当増資に関する平成 24 年 12 月 4 日付の出資引受契約に基づき、2回に分けて行うこととしていた Qualcomm を割当先とする第三者割当による新株式の発行のうち、平成 25 年 6 月 7 日開催の当社取締役会において決議しました第 2 次分の第三者割当による新株式の発行につきまして、本日、予定どおり払込みが完了しましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 新株式発行の概要

- (1) 発行新株式数 11,868,000 株
- (2) 発行価額 1 株につき 502 円
- (3) 調達資金の額 5,957,736,000 円
- (4) 増加する資本金の額 2,978,868,000 円
- (5) 増加する資本準備金の額 2,978,868,000 円
- (6) 募集又は割当方法 第三者割当の方法による。
(割当先及び割当株数) (Qualcomm Incorporated 11,868,000 株)
- (7) 払込期日 平成 25 年 6 月 24 日

2. 今回の第三者割当増資による発行済株式総数及び資本金の額の推移

増資前の発行済株式総数	1,176,623,887 株	(増資前の資本金の額	212,336,938,238 円)
増資による増加株式数	11,868,000 株	(増加する資本金の額	2,978,868,000 円)
増資後の発行済株式総数	1,188,491,887 株	(増資後の資本金の額	215,315,806,238 円)

以 上